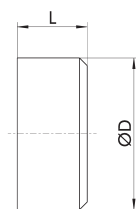




Chips de datos



Datos técnicos

Denominación	ID	Diámetro D	Longitud L	Capacidad de almacenamiento	Clase de protección IP	Temperatura ambiente mín./máx.	Temperatura mín./máx. de almacenamiento	Material de la carcasa
		[mm]	[mm]			[°C]	[°C]	
BIS-C-122-04-L	9905355	10	4.5	511 Byte	68	0 - 70	-30 - 85	Fibra óptica de resina epoxi
BIS-C-122-11-L	23002833	10	4.5	2047 Byte	68	0 - 70	-30 - 85	Fibra óptica de resina epoxi
BIS-M-122-02/A	23002987	10	4.5	2000 Byte	67	-25 - 70	-25 - 85	PA 12, junta de PU
BIS-C-122-05-L	1497154	10	4.5	1023 Byte	68	0 - 70	-30 - 85	Fibra óptica de resina epoxi



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

CMS@de.schunk.com

schunk.com